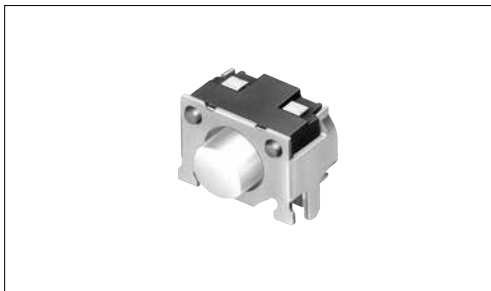


焊接强度卓越,触控灵敏的Side Push型。



主要规格



项目	规格
最大额定	50mA 12V DC
最小额定	10 $\mu$ A 1V DC
初期接触电阻	500m max.
行程 (mm)	0.2

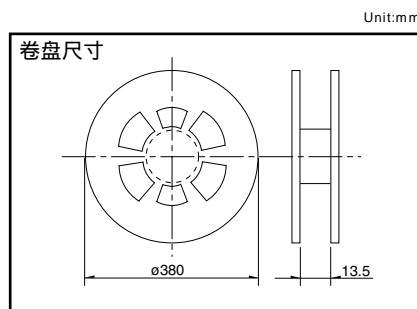
产品一览

产品编号	动作力	操作方向	操作寿命 (5mA 5V DC)	导向突起	最小订货单位 (pcs.)	
					日本	出口
□□□□□□□□	1.6N	Side push	100,000 cycles	有	3,000	3,000
□□□□□□□□				无		

包装规格

载带

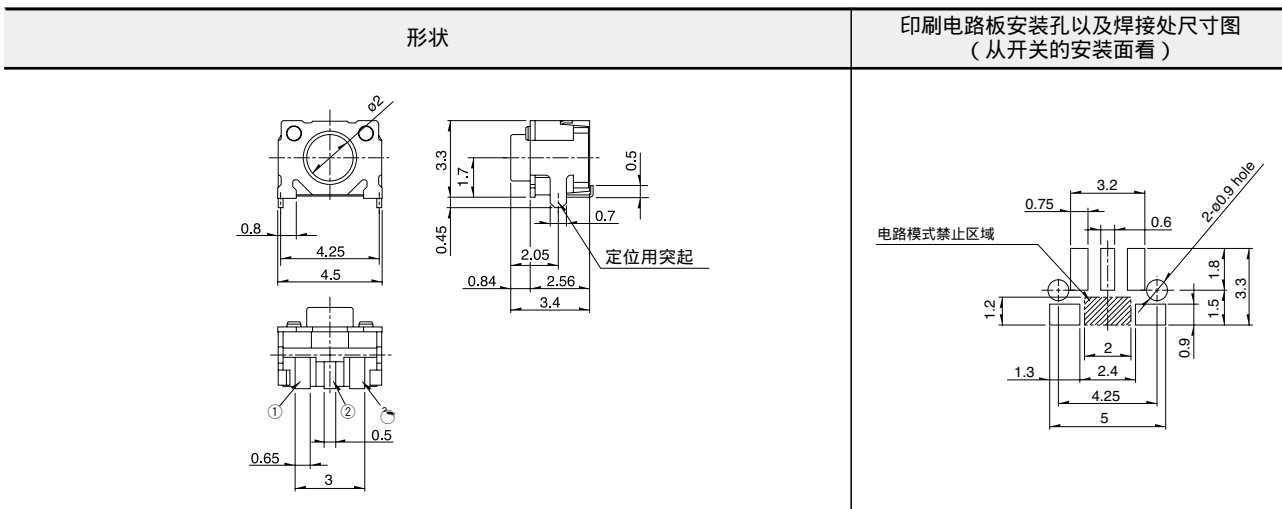
1 卷	包装数 (pcs.)		载带宽度 (mm)	出口包装箱尺寸 (mm)
	1 箱 / 日本	1 箱 / 出口包装		
3,000	30,000	30,000	12	395×395×205



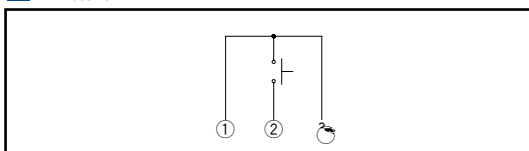
注

需要直径 330mm 的卷盘时请向本公司营业部门咨询。

外形图

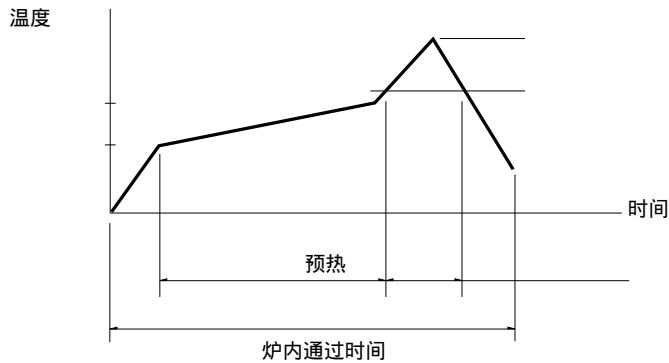


电路图





**回流焊时**  
适用于表面贴装型  
温度分布



- 注**
- 关于详细条件, 请于本公司的产品规格书进行确认。
  - 根据贴面焊槽的种类, 条件不同结果不同, 请事先充分进行确认之后使用。

**自动浸焊时**  
适用于按入式, 径向型

项目	条件
助焊剂附着量	不附着于零部件贴装面的程度
预热温度	印刷电路板焊接面的周围温度 100 max.
预热温度时间	60s max.
焊接温度	260 max.
焊接浸渍时间	5s max.
焊接次数	2 times max.

项目	条件
焊接温度	350 max.
焊接浸渍时间	3s max.
焊剂斗容量	60W max.

□□□□, □□□□ 系列

项目	条件
焊接温度	360 max.
焊接浸渍时间	3s max.
焊剂斗容量	60W max.

□□□□, □□□□, □□□□ 系列

项目	条件
焊接温度	350 max.
焊接浸渍时间	3s max.
焊剂斗容量	20W max.



□□□□Top push型, □□□□ 系列

项目	条件
助焊剂附着量	

- 注**
- 请不要从 TACT Switch™ 上面浸入助焊剂。
  - 请不要事前在开关端子及印刷电路板的零部件贴装面上涂助焊剂。
  - 进行第 2 次焊接时, 应在开关恢复到常温之后进行。
  - 请使用比重为 0.81 以上的助焊剂 (株式会社 田村製作所 EC-19S-8 同等品)。